

4971 **メック**

**前田 和夫** (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

## コア技術でIoT時代に商機をつかむ

### ◆2017年3月期第1四半期決算概要

当第1四半期の売上高は23億円(前年同期比1億15百万円増)、為替による影響は86百万円減となっている。売上高の内訳は、薬品が21億85百万円(同73百万円増)、機械が38百万円(同8百万円増)、資材が76百万円(同36百万円増)である。売上総利益は14億73百万円(同9百万円減)、修繕費等の製造経費の増加、台湾子会社の利益率の一時的な低下により減益となった。

販売費および一般管理費は9億65百万円(前年同期比21百万円減)、為替による影響が22百万円減である。その結果、営業利益が5億8百万円(同12百万円増)となった。為替による影響が12百万円減である。経常利益は4億67百万円(同70百万円減)となった。

法人税は1億10百万円(前年同期比51百万円減)、子会社留保金に対する税効果額の為替影響および日本の税率が下がったことにより減少した。四半期純利益は3億62百万円(同14百万円減)となっている。

連結貸借対照表は、流動資産では尼崎事業所建設資金借入の増加により現金および預金が63億80百万円(前年同期比16億80百万円増)、投資その他の資産で、投資有価証券が時価下落、保有株式の一部売却により3億46百万円(同70百万円減)となっている。流動負債は、尼崎事業所建設資金として、1年内返済予定の長期借入金が5億円、固定負債では尼崎事業所建設資金として長期借入金が15億円となっている。また、前期の設備関係未払金およそ9億円を設備関係支払手形へ振り替えた。円高により為替換算調整勘定は3億81百万円となった。

キャッシュフローは、税金等調整前四半期純利益の減少および仕入債務の減少により営業活動によるキャッシュフローが63百万円(前年同期比3億3百万円減)、定期預金の預入が純額で減少したことにより、投資活動によるキャッシュフローがマイナス1億6百万円(同1億37百万円増)、設備投資による借入金の増加により財務活動によるキャッシュフローが18億8百万円(同19億66百万円増)となった。その結果、現金および現金同等物の四半期末残高は51億37百万円(同11億86百万円増)となった。

### ◆主力の薬品売上が好調

当四半期のポイントとして、海外売上高比率は54.8%(前年同期比0.1ポイント増)となった。当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は75.6%(前年同期68.0%)となっている。CZシリーズの売上高は12億円(同11億25百万円)で、薬品売上高に占める割合が54.9%(前年同期比1.6ポイント増)となっている。粗利率は修繕費の増加、台湾子会社の原価の一時的な上昇により64.1%(同3.8ポイント減)となった。

売上高の四半期推移は、連結・単体ともに前期第3四半期、同第4四半期より横ばいで推移している。営業利益は、当四半期は売上高に対して利益が低迷した。経常利益、四半期純利益についても営業利益と同様の傾向を示している。

品種別四半期推移は、薬品の売上高が圧倒的に多いことには変わりはない。

薬品別では銅表面処理剤が 20 億 17 百万円で圧倒的に多いことには変わりはない。次いで、剥離剤 72 百万円、フラックス剤 46 百万円、防錆剤 27 百万円、その他 22 百万円となっている。

別区分での薬品別は、CZ シリーズや V ボンドなどの密着向上剤が 13 億 25 百万円、EXE シリーズなどのエッチング剤が 6 億 91 百万円、その他表面処理剤が 1 億 68 百万円である。当四半期は、密着向上剤の CZ シリーズが増加し、V ボンドは減少傾向で前期第 4 四半期と同様の傾向を示した。エッチング剤は減少傾向で、EXE シリーズが好調だったものの、フレキシブル基板向けやタブレット・PC 向けが減少したことが要因となった。その他はアマルファが堅調であった。

CZ シリーズの売上高推移は、CZ-8101 は 6 億 33 百万円で、前期第 4 四半期より若干減少したものの堅調に推移した。CZ-8100 は 2 億 3 百万円で減少している。

地域セグメント別売上高推移は、日本が 10 億 82 百万円で、若干減少したものの順調であった。アジアは 10 億 31 百万円、欧州は 1 億 86 百万円でいずれも増加傾向となった。

通期の連結業績予想は、売上高 89 億円、営業利益 20 億円、経常利益 20 億 50 百万円、当期純利益 14 億 50 百万円で、期初発表値から変更はないが、プラス要因も多く、為替は慎重にみていかなければならない。

## ◆今後の事業展開

当社のコア技術は、物理密着技術(CZ シリーズ、V ボンド)、化学密着技術(フラットボンドシリーズ)、微細配線形成技術(サブトラ工法技術)、表面処理技術である。

活躍分野は、自動車を含め、デバイスと呼ばれるすべての領域である。近年では、テレビ向け、スマートフォン、タブレットなどが増加している。また自動車関連や IoT、通信の 5G 化を見据えたインターネットインフラ関連にも動きがみられ、多方面にわたり開発を行っている。

IoT 時代の到来により、1 人当たりのデバイス数が飛躍的に多くなる。2020 年からは少しずつ 5G が立ち上がってくる。当社はネットワーク、インフラ、デバイスのすべてに関係しており、IoT の根幹を支える ICT 分野で、当社のコア技術が貢献するチャンスが大きく広がっている。

半導体チップは、現在の 14 ナノから 10 ナノまでいくと予測されており、さまざまなアプリケーションに対して、半導体はパッケージングが重要になってくる。当社はパッケージングに長い実績があり、今後も開発に注力していく。

フレキシブル基板は、高密度のフレキシブル基板を折りたたんで狭い部分に入れるケースが増加している。また、自動車でも使用する例が増えつつある。フレキシブル基板用材料の代表は圧延銅箔で、折り曲げに強いのが特徴である。6 月に市場投入したフレキシブル基板向けエッチング剤「UT シリーズ」は銅の物性が異なっても粗化形状を均一につくれることから、顧客から好評を得ている。これまでになかった技術であり、今後期待している。

マザーボードは SiP 化の流れがある。当社では、パッケージの基板レス化である FO-WLP(Fan Out Wafer Level Package)の普及とワンセットでとらえている。現状では、CZ シリーズや EXE シリーズの採用が増加しているが、今後も大いにチャンスがあるとみている。

スマートフォン、PC、タブレットに高いシェアを持つ CZ シリーズは開発を加速し、CZ-8201 が立ち上がってきている。さらに高性能な粗化タイプを開発中である。粗化せずに化学的に密着させるフラットタイプに関しては、量産実績が出始めている。今後、スーパーコンピュータ、AI などに採用が見込まれ、開発にも注力している。

EXE シリーズは、ディスプレイ向けに高いシェアを獲得しているが、スマートフォンなどの HDI 基板に採用が決定した会社もあり、ポジティブなインパクトが大きくなっている。特長は添加剤タイプで、現状のエッチング液に添加するだけで使用可能で、設備投資額が抑えられる。電子基板が高密度化に向かう中、セミアディティブ工法が必要となる場合もあるが、EXE シリーズならサブトラ工法でも高密度化が可能である。FPD 向けでは、4K テレビの普及が進み、需要は底堅い。今後は 8K テレビの普及が待たれる。

フラットボンドは、伝送損失を防ぐことで高周波対応のマザーボードへの採用が進捗した。

アマルファは、銅、アルミ、ニッケルなどの金属と樹脂を密着させて軽量化、あるいは工程を簡略化する。携帯端末の金属筐体で採用されており、今後は、自動車関係のモジュールでの採用を促進したい。

尼崎新事業所については、2016年10月竣工、2017年4月稼働を予定している。

今後の事業展開として、ディスプレイ関係はチャンスをとらえていきたい。樹脂金属接合分野では、技術を横展開していく。電子基板製造関連分野は、技術の変化が目覚ましいため、それに対応してビジネスチャンスを広げていきたい。グローバル展開についても引き続き、注力していく。

さらに、新製品の開発力を強化する一方、市場クレームを出さない品質保証体制という当社の強みについても強化していきたい。

## ◆ 質 疑 応 答 ◆

**前年同期比で増収を押し上げた製品は何か。**

売上が堅調だったのは CZ シリーズ、EXE シリーズである。CZ シリーズはマザーボード向け、SiP 向けの採用が進み、EXE シリーズは HDI 基板向けが動いた。

**SiP、HDI 基板向け等の売上は持続性があるものなのか。**

CZ シリーズはパッケージライクになると、マザーボードでも採用が進むと予想しており、持続性は十分あると考えている。

**アマルファの増収はスポット的なものなのか。**

アマルファが最も使われているのは携帯端末である。新機種の上り上がり、一部で 1 機種当たりの生産量が増えたことが要因である。ただし、台数が少ないので、増え方はなだらかである。

**代理店経由の海外輸出が増えた要因は何か。**

韓国に関しては、代理店経由で販売している。韓国でメモリ用パッケージ基板向けの CZ シリーズが好調だったことによる。

**経常利益が前年同期比で 13.1%減は、為替の想定レートとのギャップがあったのか。**

想定レートは 1 ドル 105 円である。為替差損に関しては、前年同期に計上した売掛金の入金との差が主な要因となっている。前年度末時点では、まだ円安状況だったため、影響差が出ているが、第 2 四半期は、どこまで為替が円高に振れるかにもよるが、それほど大きな影響はないと考えている。

**最終用途でみると、どのような製品の伸びが大きいのか。**

スマートフォンである。これまで HDI 基板でプロセスとして使われなかったものが新規に採用されており、そのあたりが伸びしろになっている。

(平成 28 年 8 月 2 日・東京)

\* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見るができます。

<http://www.mec-co.com/ir/library/>